УДК 537.32; 538.93

Ромака В.А.^{1,2}, Рогль П.³, Стаднык Ю.В⁴, Ромака Л.П.⁴, Корж Р.О.², Качаровский Д.⁵, Крайовский В.Я.², Горынь А.М.⁴

 ¹Институт прикладных проблем механики и математики им. Я. Пидстрыгача НАН Украины, ул. Научная, 3-б, Львов, 79060, Украина;
²Национальный университет "Львовская политехника", ул. С. Бандеры, 12, Львов, 79013, Украина;
³Венский университет, ул. Верингерштрасе, 42, Вена, А-1090, Австрия;
⁴Львовский национальный университет им. И. Франко, ул. Кирилла и Мефодия, 6, Львов, 79005, Украина;
⁵Институт низких температур и структурных исследований им. В. Тшебетовского Польской Академии наук, ул. Окольна, 2, Вроцлав, 50-950, Польша

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА VFe_{1-x}Ti_xSb

Исследованы кристаллическая и электронная структуры, температурные и концентрационные зависимости удельного электросопротивления и коэффициента термоЭДС термоэлектрического материала VFe_{1-x}Ti_xSb в диапазонах: T = 4.2 - 400 K и $N_A^{Ti} \approx 9.5 \cdot 10^{19} \text{ сm}^{-3}$ (x = 0.005) – $3.9 \cdot 10^{21} \text{ сm}^{-3}$ (x = 0.15). Обнаружены механизмы одновременного генерирования в кристалле структурных дефектов акцепторной и донорной природы, изменяющие степень компенсации полупроводникового материала и определяющие механизмы электропроводности.

Ключевые слова: электронная структура, электросопротивление, коэффициент термоЭДС.

The crystal and electronic structures, temperature and concentration dependencies of resistivity and thermopower coefficient of the VFe_{1-x}Ti_xSb thermoelectric material were studied in the ranges: T = 4.2 - 400 K, $N_A^{Ti} \approx 9.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ (x = 0.005) – $3.9 \cdot 10^{21} \text{ cm}^{-3}$ (x = 0.15). The mechanism of simultaneous generation of defects of donor and acceptor nature was established. They change the compensation degree of semiconductor material and determine mechanism of conduction.

Keywords: electronic structure, resistivity, thermo-power coefficient.

Введение

Как известно, оптимизация параметров термоэлектрических материалов с целью получения максимальных значений термоэлектрической добротности зависит от ряда факторов, в частности, концентрации носителей электрического тока (степени легирования), механизмов рассеяния, теплопроводности, выбора кристаллографической ориентации и т.п. [1]. Соответствующее легирование интерметаллических полупроводников, в частности, *n*-*ZrNiSn*, *n*-*TiNiSn*, *n*-*HfNiSn* и *n*-*VFeSb* (структура типа MgAgAs, пространственная группа $F\overline{4}3m$),

позволяет получить одновременно высокие значения электропроводности, коэффициента термоЭДС и небольшие значения коэффициента теплопроводности, что обеспечивает высокую эффективность преобразования тепловой энергии в электрическую и делает их наиболее исследуемыми новыми термоэлектрическими материалами [2-6].

В предложенной работе, в продолжение исследования влияния сильного легирования (*N*_a, $N_d \sim 10^{19} \div 10^{21} \text{ см}^{-3}$) данного класса полупроводников на их структурные, энергетические, электрофизические и магнитные свойства [2], определены условия возникновения максимума коэффициента термоэлектрической мощности Z^* ($Z^* = \alpha^2 \cdot \sigma$, где α – коэффициент термоЭДС, σ – удельная электропроводность) при легировании *n*-VFeSb атомами Ti, введенными в соелинение путем замещения атомов Fe. Проведенное исследование также продемонстрировало, что получение положительного результата, например, высоких значений Z^* , без понимания глубинных процессов в структуре материала и механизмов электропроводности, как правило, носит случайный характер и не позволит разработать технологию получения высокоэффективных материалов для преобразования тепловой энергии в электрическую.

Методики исследований

Исследовалась кристаллическая структура, распределение плотности электронных состояний (DOS), кинетические и энергетические характеристики $VFe_{1,x}Ti_xSb$. Образцы синтезированы в лаборатории Института физической химии Венского университета. Методом рентгеноструктурного анализа с использованием программы Fullprof [7] определены значения периодов кристаллической решетки. Для расчетов структурных характеристик использовались массивы данных, полученные порошковым методом (дифрактометр Guinier-Huber image plate system). Химический и фазовый составы образцов контролировали сканирующим электронным микроскопом (SEM, Zeiss Supra 55VP) и микрозондовым анализатором (EPMA, energydispersive X-ray analyzer). Электронная структура рассчитана методом Коринги-Кона-Ростокера (ККR) в приближении когерентного потенциала (СРА) и локальной плотности (LDA) [8]. Для расчетов использованы экспериментальные значения постоянной элементарной ячейки на k-сетке размером $10 \times 10 \times 10$ и тип параметризации корреляционного потенциала Moruzzi-Janak-Williams [9]. Ширина энергетического окна, охваченного контуром, равна 16 эВ. Число значений энергии для расчетов DOS составляло 1000. Измерялись температурные и концентрационные зависимости удельного электросопротивления (ρ) и коэффициента термоЭДС (а) образцов $VFe_{l,x}Ti_xSb$ по отношению к меди в диапазонах: T = 4.2 - 400 К, $N_A^{Ti} \approx 9.5 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3} (x = 0.005) - 3.9 \cdot 10^{21} \text{ cm}^{-3} (x = 0.15).$

Исследование электрокинетических и энергетических характеристик VFe_{1-x}Ti_xSb

Первичное тестирование образцов $VFe_{1-x}Ti_xSb$ на предмет их однородности, присутствия неконтролируемых фаз и факта растворения атомов примеси в матрице соединения VFeSb, выполненное с помощью рентгеновских фазового и структурного анализов, не выявило следов других фаз, кроме основной. В свою очередь, значения периода элементарной ячейки возрастали, что логично – ведь атомный радиус *Ti* ($r_{Ti} = 0.145$ нм) больше такового у *Fe* ($r_{Fe} = 0.127$ нм). Результаты тестирования служили основой для дальнейшего проведения электрокинетических исследований.

Учитывая, что исследуется твердый раствор $VFe_{1-x}Ti_xSb$, логически начать с анализа характеристик базового полупроводника *n*-VFeSb. На рис. 1 приведены температурные зависимости удельного электросопротивления $\ln \rho(1/T)$ и коэффициента термоЭДС $\alpha(1/T)$. Видно, что в диапазоне T = 4.2 - 80К проводимость имеет активационный характер и является прыжковой проводимостью с переменной длиной прыжка (*vrh*) ε_3^{ρ} [10], на что указывает линейная зависимость $\ln(\rho(1/T)^{1/4})$ (вставка на рис. 1).



Рис. 1. Температурные зависимости удельного электросопротивления $ln(\rho(1/T) (1) u$ коэффициента термоЭДС $\alpha(1/T) (2)$ n-VFeSb. Вставка: зависимость $ln(\rho(1/T)^{1/4})$ в диапазоне T = 12 - 80 K.

В свою очередь, отрицательные значения коэффициента термоЭДС свидетельствуют о том, что электроны являются основными носителями заряда. При повышении температуры (T > 80 K) активационная проводимость переходит в зонную (металлическую), определяемую свободными электронами, а уровень Ферми ε_F переходит из примесной донорной зоны в зону проводимости. При таких условиях значения $\rho(T)$ возрастают с увеличением температуры вследствие рассеяния (рис. 2*a*, кривая 1).



Рис. 2. Температурные зависимости удельного электросопротивления р VF $e_{1-x}Ti_xSb$: a: 1 - x = 0, 2 - x = 0.01, 3 - x = 0.02; 6: 1 - x = 0.03, 2 - x = 0.05, 3 - x = 0.10, 4 - x = 0.15.

В области перехода от активационной проводимости к зонной (стрелка на рис. 1) удалось определить энергию активации с уровня Ферми ε_F в зону проводимости $\varepsilon_1^{\rho} = 1.6 \text{ мэВ}$. С другой стороны, то, что прыжковая проводимость является определяющей до 80 K, а между зоной проводимости и примесной зоной существует небольшая энергетическая щель, указывает на значительную ширину примесной зоны (~7 мэВ).

Введение в соединение *VFeSb* атомов *Ti* путем замещения атомов *Fe* должно бы генерировать в кристалле структурные дефекты акцепторной природы, поскольку *Ti* $(3d^{24}s^2)$ имеет на четыре 3*d*-электрона меньше, чем *Fe* $(3d^{64}s^2)$. На рис. 2-4 приведены температурные и концентрационные зависимости удельного электросопротивления и коэффициента термоЭДС *VFeSb*. Поскольку в *n-VFeSb* уровень Ферми ε_F находится в зоне проводимости, то легирование полупроводника наименьшими концентрациями акцепторной примеси *Ti* должно было бы привести к уменьшению концентрации свободных электронов и дрейфу уровня Ферми ε_F ко дну зоны. Как видно из рис. 2*a*, в диапазоне концентраций *VFe*_{1-x}*Ti*_x*Sb*, $0 \le x \le 0.02$, проводимость полупроводника все еще имеет неактивационный, металлический характер, указывая на расположение уровня Ферми в зоне проводимости. Однако вызывает удивление тот факт, что при фиксированной температуре в этом же диапазоне концентраций значения $\rho(x)$ уменьшаются (рис. 3*a*).



Рис. 3. Изменение значений удельного электросопротивления $\rho(x)(a)$ и коэффициента термоЭДС $\alpha(x)(b)$ VF $e_{1x}Ti_xSb$ при разных температурах: 1 - T = 80 K, 2 - T = 160 K, 3 - T = 380 K.

Например, при T = 160 К значение $\rho(x = 0) = 24.28$ мкОм·м уменьшается до $\rho(x = 0.005) = 5.11$ мкОм·м и $\rho(x = 0.01) = 4.96$ мкОм·м. То есть, введением в *n*-VFeSb гигантского числа акцепторов ($N_A^{Ti} \approx 3.8 \cdot 10^{20}$ см⁻³) не только не удалось «вытянуть» уровень Ферми в запрещенную зону, а наоборот, проводимость увеличилась, что в полупроводнике возможно лишь при увеличении числа свободных электронов. Данный результат позволяет предположить, что в кристалле VFe_{1-x}Ti_xSb одновременно с акцепторами генерируются доноры по неизвестному до сих пор механизму. Другим вариантом объяснения такого поведения $\rho(x)$ является предположение о ликвидации полупроводникового состояния материала.

При концентрациях $N_A^{Ti} \approx 5.7 \cdot 10^{20} - 1.9 \cdot 10^{21}$ см⁻³ (x = 0.03 - 0.15) температурные зависимости удельного электросопротивления $VFe_{1-x}Ti_xSb$ прогнозируемо приобретают

полупроводниковый характер (рис. 26) указывая, что уровень Ферми ε_F вышел из зоны проводимости в запрещенную зону. Данный результат подтверждает акцепторную природу структурных дефектов, возникающих в кристалле $VFe_{1-x}Ti_xSb$, что является причиной стремительного роста значений $\rho(x)$ (рис. 3*a*). В то же время, характер изменения значений коэффициента термоЭДС $\alpha(x)$ (рис. 3*б*, 4) свидетельствует о том, что уровень Ферми располагается теперь вблизи валентной зоны, поскольку значения коэффициента термоЭДС положительны.

Из активационных участков зависимостей $\ln(1/T)$ (рис. 26) рассчитаны значения энергий активации с уровня Ферми ε_F на уровень протекания зоны проводимости (валентной зоны) ε_1^{ρ} и прыжки электронов ε_3^{ρ} по состояниям с энергиями, близкими к уровню Ферми, а из активационных участков зависимостей $\alpha(1/T)$ (рис. 4) – значение энергий активации ε_1^{α} и ε_3^{α} , которые дают, соответственно, значения амплитуды модуляции зон непрерывных энергий и мелкомасштабной флуктуации сильно легированного и сильно компенсированного полупроводника (рис. 5) [2, 10]. Понятно, что чем выше степень компенсации, тем больше амплитуда модуляции [10]. Напомним, что степень компенсации показывает соотношение числа ионизированных доноров и акцепторов: чем более близки их значения, тем выше степень компенсации; при полной компенсации число акцепторов и доноров одинаково. В случае *n-VFeSb* значение амплитуды крупномасштабной флуктуации $\varepsilon_1^{\alpha} = 41.5$ мэВ, а глубина потенциальной ямы $\varepsilon_3^{\alpha} = 0.2$ мэВ.



Рис. 4. Температурные зависимости коэффициента термо ЭДС $\alpha(1/T)$ VFe_{1-x}Ti_xSb : 1 – x=0.03, 2 – x=0.05, 3 – x=0.10, 4 – x=0.15, 5 – x=0.005, 6 – x=0.02, 7 – x=0.

Замещение в соединении *VFeSb* наименьшего в эксперименте числа атомов *Fe* атомами *Ti* (x = 0.005) ожидаемо сопровождается стремительным увеличением степени компенсации полупроводника, на что указывает рост зависимости $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$ на участке *VFe*_{1-x}*Ti*_x*Sb*, x = 0 - 0.005 (рис. 5*a*). Однако дальнейшее введение акцепторной примеси в полупроводник еще электронного типа проводимости ($\alpha(x) < 0$), когда уровень Ферми ε_F все еще находится в зоне проводимости, неожиданно сопровождается таким же стремительным уменьшением значений амплитуды модуляции зон непрерывных энергий $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$. Такое уменьшение значений $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$ на

участке концентраций 0.005 < x < 0.03 возможно лишь при условии генерирования в кристалле одновременно с акцепторами и доноров по неизвестному до сих пор механизму. Причем на участке концентраций 0.005 < x < 0.03 скорость генерирования доноров в $VFe_{1-x}Ti_xSb$ выглядит большей, чем акцепторов. Подобный вывод был также сделан на основе поведения $\rho(x)$ на этом же концентрационном участке, когда при введении в полупроводник электронного типа проводимости акцепторной примеси значения $\rho(x)$ не возрастали, как ожидалось, а уменьшались (рис. 3a). Можем оценить границы концентрации неконтролируемых доноров N_D : $3.6 \cdot 10^{20}$ см⁻³ (x = 0.02) $< N_D < 5.7 \cdot 10^{20}$ см⁻³ (x = 0.03). Другим вариантом такого поведения $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$ на участке концентраций 0.005 < x < 0.03 является предположение о ликвидации полупроводникового состояния материала.

Проводимость $VFe_{1-x}Ti_xSb$ (0.03 $\leq x \leq$ 0.15) носит полупроводниковый характер, а значение $\alpha(x) > 0$, указывая на смену типа основных носителей от электронов до дырок. Итак, скорость и концентрация генерированных акцепторов превышают скорость и концентрацию доноров. Как следствие, степень компенсации уменьшается, на что указывает убывание зависимости $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$ (рис. 5 *a*).



Рис. 5. Изменение значений энергий активации $\varepsilon_1^{\alpha}(1) u \varepsilon_1^{\rho}(2)(a) u \varepsilon_3^{\alpha}(1) u \varepsilon_3^{\rho}(2)(b) VFe_{I-x}Ti_xSb.$

При концентрациях примеси *Ti*, когда материал проявляет полупроводниковые свойства, на факт дрейфа уровня Ферми ε_F к валентной зоне указывает характер изменения значений энергии активации $\varepsilon_1^{\rho}(x)$ с уровня Ферми ε_F на край валентной зоны (рис. 5 *a*). Видно, что энергетическая щель между уровнем Ферми и краем валентной зоны уменьшается от $\varepsilon_1^{\rho}(x=0.03) = 21.7$ мэВ до $\varepsilon_1^{\rho}(x=0.15) = 6.1$ мэВ, а концентрация примеси *Ti* оказалась недостаточной для пересечения уровнем Ферми валентной зоны.

Прогнозируемым является поведение энергии активации прыжковой проводимости $\varepsilon_3^{\rho}(x)$ в $VFe_{1-x}Ti_xSb$, $0.03 \le x \le 0.15$. То, что значение энергии $\varepsilon_3^{\rho}(x)$ стремительно уменьшается, связано с увеличением перекрытия волновых функций акцепторов в силу значительной их концентрации ($N_A^{Ti} \approx 3.9 \cdot 10^{21}$ см⁻³ (x = 0.15)). Вместо этого глубина потенциальной ямы мелкомасштабной флюктуации, пропорциональная ε_3^{α} , начинает уменьшаться лишь после пересечения уровнем Ферми середины запрещенной зоны, что согласуется с характером изменения значений амплитуды модуляции зон непрерывных энергий $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$.

Коэффициент термоэлектрической мощности *VFe_{1-x}Ti_xSb*

На рис. 6 представлено изменение значений коэффициента термоэлектрической мощности $Z^*(x)$, из которого видно, что в диапазоне концентраций 0 < x < 0.03 значения $Z^*(x)$ в $VFe_{1-x}Ti_xSb$ являются большими, чем в нелегированном полупроводнике *n*-*VFeSb*. Из рис. 6 также следует, что при пересечении уровней Ферми и протекания зоны проводимости, когда еще высоки значения коэффициента термоЭДС и уже высокими стали значения удельной электропроводности $VFe_{1-x}Ti_xSb$, на зависимостях $Z^*(x)$ наблюдаются экстремумы при всех исследованных температурах, что соответствует критерию достижения максимальных значений коэффициента термоэлектрической мощности Z^* [2].



Рис. 6. Изменение значений коэффициента термоэлектрической мощности $Z^* VFe_{1-x}Ti_xSb$: 1 - T = 380 K; 2 - T = 250 K; 3 - T = 160 K; 4 - T = 80 K.

Таким образом, на основе приведенных результатов электрокинетических исследований можно утверждать, что полученный твердый раствор $VFe_{1-x}Ti_xSb$ является перспективным термоэлектрическим материалом. Однако уровень проведенных исследований не позволил однозначно идентифицировать механизмы электропроводности, что делает невозможным прогнозирование кинетических характеристик $VFe_{1-x}Ti_xSb$ и разработку технологии получения термоэлектрического материала с высокой эффективностью преобразования тепловой энергии в электрическую. Это побудило к углубленным исследованиям как пространственного расположения атомов в $VFe_{1-x}Ti_xSb$, так и электронной структуры полупроводника.

Уточнение кристаллической и электронной структур VFe_{1-x}Ti_xSb

Прежде всего необходимо понять, что определяет электронный тип проводимости соединения VFeSb. Микрозондовый анализ поверхности образцов VFeSb выявил дефицит атомов Sb на ~1%. Подобный результат получен в [11]; его можно объяснить наличием структурных дефектов в виде вакансий в позиции 4b атомов Sb. Уточнение кристаллической структуры VFeSb в силу малой концентрации структурных дефектов не позволило идентифицировать вакансии: модели кристаллических структур находились в пределах погрешности как для варианта 100%-го занятия атомами своих позиций, так и для варианта существования ~1% вакансий атомов Sb. Исходя из упорядоченной модели структуры VFeSb , в которой все атомы занимают позиции в соответствии со структурным типом MgAgAs и степень

занятости составляет 100%, рассчитаны значения периода кристаллической решетки a(x) (рис. 7*a*).



Рис. 7. Изменение значений периода кристаллической решетки a(x) (a), а также рассчитанных значений плотности состояний на уровне Ферми $g(\varepsilon_F)$ и удельного электросопротивления $\rho(x)$ (б) VF $e_{1x}Ti_xSb$: a: 1 – расчеты при замещении атомов Fe атомами Ti; 2 – экспериментальные результаты, 3 – расчеты при замещении атомов V атомами Ti; б: $1 - g(\varepsilon_F)$, $2 - \rho(x)$.

Оказалось, что значение периода, полученное из эксперимента, является меньшим прогнозируемого расчетами: $a_{_{экс.}} = 0.5818$ нм и $a_{_{расч.}} = 0.5827$ нм. Возникает вопрос, что является причиной такого различия? Если вспомнить, что микрозондовый анализ выявил дефицит Sb на ~1% [11], а также предположение, что это может быть проявлением вакансий в позиции 4b атомов Sb, то различие в значениях периода решетки VFeSb может служить весомым аргументом для подтверждения такого предположения.

С другой стороны, предположение относительно наличия в структуре VFeSb вакансий в позиции 4b, что эквивалентно генерированию доноров, выглядит логичным, поскольку согласуется с приведенными выше результатами кинетических исследований *n*-VFeSb, указывавших на существование в полупроводнике доноров неизвестного происхождения. Так, отрицательные значения коэффициента термоЭДС VFeSb и наличие прыжкового механизма переноса заряда по образованной дефектами примесной донорной зоне является еще одним аргументом относительно предположения о наличии вакансий в позиции атомов Sb (4b).

Учитывая, что атомный радиус Ti больше такового у Fe, то увеличение значений периода кристаллической решетки a(x) $VFe_{1-x}Ti_xSb$ при увеличении содержания Ti (рис. 7a, кривая 2) объяснено. Исходя из предположения, что легирование *n*-VFeSb атомами Ti сопровождается упорядочением кристаллической структуры, а примесные атомы Ti вытесняют из кристаллографической позиции 4c атомы Fe, было рассчитано изменение значений a(x) (рис. 7a, кривая 1). При расчетах мы предполагали, что исходное соединение VFeSb является упорядоченным.

Сопоставление двух зависимостей – изменения значений периода элементарной решетки a(x), полученных из эксперимента и рассчитанных для случая замещения атомов *Fe* атомами *Ti*, показывает, что скорость изменения значений a(x), полученная из эксперимента, на участке концентраций $0 \le x \le 0.01$ совпадает со скоростью изменения a(x), полученной расчетным путем (одинаковый угол наклона зависимостей 1 и 2 на рис. *7a*). Такая согласованность

поведения a(x) указывает, что в соединении VFeSb на этом участке атомы Fe в основном вытесняются атомами Ti.

В то же время характер изменения рассчитанных значений a(x) в случае замещения атомов *Fe* атомами *Ti* на участке концентраций x > 0.01 принципиально отличается от результатов эксперимента (рис. 7*a*, кривая 1). Поскольку атомный радиус *Sb* ($r_{Sb} = 0.159$ нм) является самым большим в соединении *VFeSb*, то увеличение значений a(x) возможно лишь при замещении атомами *Ti* атомов меньших размеров: или атомов *Fe*, или *V* ($r_v = 0.135$ нм), или этих атомов одновременно в разных соотношениях. Результат расчетов изменения значений a(x) на участке концентраций x > 0.01 в случае, когда бы атомы *Ti* замещали лишь атомы *V* (рис. *7a*, кривая 3), близок к результатам эксперимента, однако не совпадает с ним.

Таким образом, структурные исследования позволяют утверждать, что в разных концентрационных диапазонах атомы Ti одновременно в разных соотношениях занимают кристаллографические позиции атомов Fe и V: в диапазоне концентраций $0 \le x \le 0.01$ атомы Ti в большей мере занимают позицию атомов Fe, а в диапазоне x > 0.01 – позицию атомов V.

Для более глубокого понимания физических процессов в реализованном твердом растворе проведены расчеты электронной структуры для обоих крайних случаев: замещение в соединении *VFeSb* атомов *Fe* атомами *Ti* и атомов *V* атомами *Ti* (рис. 8). Так, расчеты плотности электронных состояний на уровне Ферме $g(\varepsilon_F)$ для случая замещения в соединении *VFeSb* атомов *Fe* атомами *Ti* показывают, что значения $g(\varepsilon_F)$ лишь увеличиваются в диапазоне концентраций $VFe_{1-x}Ti_xSb$, $0 \le x \le 0.15$, а рассчитанные на этой основе значения удельного сопротивления $\rho(x)$ уменьшаются, что характерно для металла (рис. 76). Такой результат, как показывает расчет плотности электронных состояний *DOS* (рис. 8*a*), является следствием исчезновения запрещенной зоны в случае введения в соединение *VFeSb* уже наименьшей концентрации примеси *Ti* (x = 0.005) путем замещения атомов *Fe*.



Рис. 8. Расчеты плотности электронных состояний DOS для вариантов упорядоченной структуры $VFe_{1,x}Ti_xSb(a) u V_{0.97}Ti_{0.03}FeSb(6)$

Следует вспомнить, что температурные и концентрационные зависимости удельного электросопротивления исследовались именно в диапазоне $0 \le x \le 0.02$, когда проводимость имела металлический характер, а добавление будто бы акцепторной примеси *Ti* в полупроводник электронного типа проводимости *n*-*VFeSb* неожиданно сопровождалось уменьшением значений удельного сопротивления. Именно такой результат – увеличение

плотности электронных состояний на уровне Ферми $g(\varepsilon_F)$ и, как следствие, уменьшение электросопротивления, дают расчеты электронной структуры для случая замещения в соединении VFeSb атомов Fe атомами Ti. Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что при введении в соединение VFeSb атомов Ti на участке концентраций $0 \le x \le 0.02$ последние в большей мере вытесняют атомы Fe, что сопровождается исчезновением запрещенной зоны, а полученный материал VFe_{1-x}Ti_xSb является металлом.

С другой стороны, расчеты плотности электронных состояний *DOS* для другого крайнего случая показали, что замещение атомов V в соединении $VFe_{1-x}Ti_xSb$ атомами *Ti* при концентрациях на порядок больших (x = 0.03) не разрушает полупроводникового состояния $V_{0.97}Ti_{0.03}FeSb$; уровень Ферми ε_F при этом находится в запрещенной зоне вблизи потолка валентной зоны (рис. 86). Именно такой результат дали экспериментальные исследования удельного электросопротивления и коэффициента термоЭДС при $x \ge 0.03$, когда температурные изменения значений удельного электросопротивления имели активационный характер, а значения коэффициента термоЭДС были положительными.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что при введении в соединение *VFeSb* атомов *Ti* при концентрациях $x \ge 0.03$ последние преимущественно вытесняют атомы *V*, что сопровождается появлением запрещенной зоны и генерированием в кристалле структурных дефектов акцепторной природы, а полученный материал является полупроводником. Поскольку исследования $VFe_{1-x}Ti_xSb$ показали, что имеет место одновременное замещение атомами *Ti* позиций атомов *V* и *Fe* в разных соотношениях, в зависимости от концентрации примеси, установить точную пропорцию такого замещения в настоящее время проблематично.

Выводы

Исследование процесса введения в соединение VFeSb атомов Ti показало сложный механизм одновременного замещения в разных соотношениях, в зависимости от концентрации примесных атомов, как кристаллографической позиции атомов Fe, так и атомов V. Полученный результат позволяет прогнозировать поведение кинетических характеристик $VFe_{1-x}Ti_xSb$ и получить материал с высокой эффективностью преобразования тепловой энергии в электрическую.

Работа выполнена в рамках гранта МОН Украины, № 0112U001279.

Литература

- 1. Анатычук Л.И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства /Л.И. Анатычук // К.: Наукова думка, 1979. 768 с.
- Ромака В.А. Интерметаллические полупроводники: свойства и использование / В.А.Ромака, В.В. Ромака, Ю.В. Стаднык // Львов, Львовская политехника, 2011, 488 с.
- 3. Tritt T.M., Sabramanian M.A. Thermoelectric Materials, Phenomena, and Applications: A Bird's Eye View // MRS Bulletin, 2006 Vol. 31, № 3 P. 188-198.
- Nolas G.S., Poon J., Kanatzidis M. Recent Developments in Bulk Thermoelectric Materials // MRS Bulletin, 2006 – Vol. 31, № 3 – P. 199-205.
- Romaka V.V., Rogl P., Romaka L., Stadnyk Yu., Grytsiv A., Lakh O., Krayovsky V. Peculiarites of Structural disorder in Zr- and Hf- Containing Heusler and Half-heusler Stannides // Intermetallics, 2013 – Vol. 35 – P. 45-52.

Ромака В.А., Рогль П., Стаднык Ю.В, Ромака Л.П, Корж Р.О., Качаровский Д., Крайовский В.Я... Особенности структурных, энергетических и кинетических характеристик термоэлектрического...

- Romaka V.V., Romaka L., Stadnyk Yu., Gvozdetskii V., Gladyshevskii R., Skryabina N., Melnychenko N., Hlukhyy V., Fässler T. Interaction of Vanadium with Iron and Antimony at 870 and 1070 K // Eur. J. Inorg. Chem., 2012 – Vol. 2012, Issue 15 – P. 2588–2595.
- 7. Roisnel T., Rodriguez-Carvajal J. WinPLOTR: a Windows tool for powder diffraction patterns analysis // Mater. Sci. Forum, Proc. EPDIC7, 2001 Vol. 378-381 P. 118–123.
- Schruter M., Ebert H., Akai H., Entel P., Hoffmann E., Reddy G.G. First-principles investigations of atomic disorder effects on magnetic and structural instabilities in transition-metal alloys // Phys. Rev. B, 1995 – Vol. 52 – P. 188-209.
- 9. Moruzzi V.L. Calculated electronic properties of metals / V.L. Moruzzi, J.F. Janak, A.R. Williams // (NY, Pergamon Press, 1978, 348 p.
- 10. Шкловский Б.И. Электронные свойства легированных полупроводников / Б.И. Шкловский, А.Л. Эфрос // М.: Наука, 1979, 416 с.
- Chenguang Fu, Hanhui Xie, Yintu Liu, Zhu T.J., Jian Xie, Zhao X.B. Thermoelectric properties of FeVSb half-Heusler compounds by levitation melting and spark plasma sintering // Intermetallics, 2013 – Vol. 32 – P. 39-43.

Поступила в редакцию 02.10.14.